附件2

技术产品创新揭榜任务征集表

具体要求：聚焦重点人工智能技术产品创新，补短板、锻长板，研提揭榜攻关需求，量化攻关指标，加快关键核心技术突破，提升产品智能化水平，夯实产业发展基础，构筑新优势。（每项需求填写一份表格）

|  |
| --- |
| 技术产品创新揭榜任务 |
| 研提单位 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 技术产品名称 | *示例：高性能云端人工智能芯片* |
| 所属方向 | □智能芯片□智能传感器□AI算法和框架□智能网联汽车□智能识别系统□智能医疗装备□智能机器人□智能制造关键装备□智能教育产品□AI安全与治理□人工智能开放平台□其他  |
| 揭榜任务 | （概述揭榜任务，包括具体技术产品攻关任务，需突破的技术短板、创新点，解决的关键技术难题等。限300字）*示例：研制高性能云端人工智能芯片，突破适用于人工智能计算范式的矩阵乘加内核架构、新一代高带宽内存、内存原子操作、高速互联总线、协处理机制和超大芯片封装等核心技术，满足混合云环境中的低能耗训练和推理。* |
| 指标建议 | （明确提出1-2年的预期目标及指标参数，且应领先于当前国内技术产品性能功能水平。限200字）*示例：到2022年，训练芯片达到500TFlops/s（半精度浮点），推理芯片达到300T ops/s（INT8），能效比超2TFLOPS/w；可支持各类深度学习和经典机器学习算法，在自动驾驶、智能医疗装备、智能家居、智能终端等重点领域实现规模化商用。* |
| 必要性及预期成果 | （简述揭榜任务重要性、必要性和紧迫性，预期成果，以及主要经济、社会效益。限500字内）*示例：略。* |
| 研发投入预测 | 研发总预算 万元。 |
| 评测方法建议 | 对所提指标参数进行评测的方法依据，如依据标准或者测试方法等的建议。 |